

【Reference Data】FOMA UM01-KO アダプタセット

有害物質含有情報調査結果

NTTDOCOMO Highly Confidential
 ©2008 NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved
 FOMAユビキタスマジュール

本資料はJGPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
 詳細はJGPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 をご参照いただきますようお願いいたします。
 ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度:最大値、含有質量:総含有量を記載し、横に個数を併記しております。
 ①コンデンサ、抵抗 → 大きさ(縦×横)
 ②ダイオード、トランジスタ → 用途
 ③コイル → 形状

- ・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただき場合がございます。
- ・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約 情報の取り扱い」に定められた文書となります。
- ・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いいたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度 (ppm)	含有質量 (mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
レベルA (禁止物質)	A05	カドミウム又はその化合物	N	16	0.000024	PA1	はんだ合金中の不純物		
			N	16	0.000024	PA2	はんだ合金中の不純物		
			N	20	0.0056	モジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
			N	74	0.26	コネクタ2のシェル	黄銅の不純物		
			N	5.0	0.0023	Wセムスネジ1	黄銅の不純物		
			N	5.0	0.0036	Wセムスネジ2	黄銅の不純物		
	A07	六価クロム化合物	N	200	0.0015	付属ネジ	三価クロム表面処理での非意図的生成	閾値以下	
	A09	鉛及びその化合物	Y	180,000	0.0027	アイソレータ2のセラミック基板抵抗ペースト	ガラス成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス中の鉛	
			Y	1,300	0.0027	アイソレータ1のセラミック基板抵抗ペースト	ガラス成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス中の鉛	
			Y	500	0.0017	コネクタ1の雄端子	銅合金の成分	鉛が4wt%以下の銅合金中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			Y	500	0.0050	コネクタ1のシェル	銅合金の成分	鉛が4wt%以下の銅合金中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			Y	19,000	0.0064	多連チップ抵抗1の電極	電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス中の鉛	
			Y	250,000	0.046	多連チップ抵抗1の抵抗体	抵抗体成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス中の鉛	
			Y	450,000	0.076	多連チップ抵抗1のアンダーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス中の鉛	
			Y	700,000	0.86	多連チップ抵抗1のオーバーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス中の鉛	
Y			64,000	0.0088	多連チップ抵抗1の側面電極	側面電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラス中の鉛		
Y			76	0.0028	モジュール基板の無電解ニッケルメッキ	メッキ液添加剤	閾値以下 ネットワーク・インフラを構成する通信装置のポリ塩化ビニルケーブル及び無電解ニッケルメッキに含まれる鉛		
N			12	0.00080	モジュール基板のレジストインク	不純物			
N			1.6	0.0011	モジュール基板の銅メッキ	不純物			
N			2.9	0.0029	モジュール基板のブリブリ	不純物			
N			18	0.010	モジュール基板のコア材	不純物			
Y	1,000	3.0	シールドケース上	銅の合金成分	鉛が4wt%以下の銅合金中の鉛(真鍮、りん青銅等)				
Y	1,000	3.5	シールドケース下	銅の合金成分	鉛が4wt%以下の銅合金中の鉛(真鍮、りん青銅等)				
N	440	0.00066	PA1	はんだ合金中の不純物					
Y	100	0.000060	PA1のチップ部品セラミック	特性を得るため	電子セラミック部品中の鉛				
Y	13,000	0.0015	PA1のチップ部品端子	端子電極ガラス	電子セラミック部品中の鉛				
Y	14,000	0.00045	PA1のチップ部品端子	端子電極ガラス	電子セラミック部品中の鉛				
N	440	0.00066	PA2	はんだ合金中の不純物					

【Reference Data】FOMA UM01-KO アダプタセット 有害物質含有情報調査結果

本資料はJGPGSSI(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGPGSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
 詳細はJGPGSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 をご参照いただきますようお願いいたします。
 ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度:最大値、含有質量:総含有量を記載し、横に個数を併記しております。
 ①コンデンサ、抵抗 → 大きさ(縦×横)
 ②ダイオード、トランジスタ → 用途
 ③コイル → 形状

- ・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただき場合がございます。
- ・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約 情報の取り扱い」に定められた文書となります。
- ・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度 (ppm)	含有質量 (mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
レベルA (禁止物質)	A09	鉛及びその化合物	Y	100	0.00035	PA2のチップ 部品セラミック	特性を得るため	電子セラミック部品の中の鉛	
			Y	13,000	0.0011	PA2のチップ 部品端子	端子電極ガラス	電子セラミック部品の中の鉛	
			Y	20,000	0.022	チップ抵抗(1005)(112個)の電極	電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	270,000	0.078	チップ抵抗(1005)(112個)の抵抗体	抵抗体成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	510,000	0.45	チップ抵抗(1005)(112個)のアンダーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			N	500	0.14	モジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
			Y	310	0.060	インタフェイスICのリードフレーム	含有元素	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			Y	1,000	1.5	タンシ	銅合金成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			Y	37,000	130	コネクタ2の雌雌中継端子・シェル	銅合金成分	鉛が4wt%以下の銅合金の中の鉛(真鍮、りん青銅等)	
			N	640	0.32	PB用コネクタ2の端子部・金具	銅合金不純物		
			Y	19,000	0.0016	多連チップ抵抗2の電極	電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	250,000	0.011	多連チップ抵抗2の抵抗体	抵抗体成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	450,000	0.019	多連チップ抵抗2のアンダーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	700,000	0.21	多連チップ抵抗2のオーバーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	64,000	0.0022	多連チップ抵抗2の側面電極	側面電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			N	500	0.0270	RFケーブルの雌端子・シェル	銅合金不純物		
			N	500	0.23	Wセムスネジ1	銅合金不純物		
			N	500	0.36	Wセムスネジ2	銅合金不純物		
			Y	130	0.00041	アダプタ基板の無電解ニッケルメッキ	メッキ液添加剤	閾値以下 ネットワーク・インフラを構成する通信装置のホリ塩化ビニールケーブル及び無電解ニッケルメッキに含まれる鉛	
			Y	16,000	0.0066	チップ抵抗(1608)(11個)の電極	電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	250,000	0.023	チップ抵抗(1608)(11個)の抵抗体	抵抗体成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	500,000	0.059	チップ抵抗(1608)(11個)のアンダーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	6,000	0.0008	チップ抵抗(3216)(1個)の電極	電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	250,000	0.016	チップ抵抗(3216)(1個)の抵抗体	抵抗体成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	450,000	0.016	チップ抵抗(3216)(1個)のアンダーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	620,000	0.35	チップ抵抗(3216)(1個)のオーバーコート	保護膜成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			Y	76,000	0.026	チップ抵抗(3216)(1個)の側面電極	側面電極成分	CRT、電子部品、蛍光管に使用されるガラスの中の鉛	
			N	500	0.047	アダプタ部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		

【Reference Data】FOMA UM01-KO アダプタセット 有害物質含有情報調査結果

本資料はJGPFSS(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGPFSS 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
 詳細はJGPFSS 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 をご参照いただきますようお願いいたします。
 ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度:最大値、含有質量:総含有量を記載し、横に個数を併記しております。
 ①コンデンサ、抵抗 → 大きさ(縦×横)
 ②ダイオード、トランジスタ → 用途
 ③コイル → 形状

- ・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただき場合がございます。
- ・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約 情報の取り扱い」に定められた文書となります。
- ・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度 (ppm)	含有質量 (mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
レベルA (禁止物質)	A10	水銀またはその化合物	N						
	A17	ビス(トリブチルスズ)＝オキシド(TBTO)	N						
	A18	トリブチルスズ類(TBT類)及びトリフェニルスズ類(TPT類)	N						
	B02	ポリ臭化ビフェニール類(PBB)	N						
	B03	ポリ臭化ジフェニールエーテル類(PBDE)	N						
	B05	ポリ塩化ビフェニル類(PCB)	N						
	B06	ポリ塩化ナフタレン(塩素係数が3以上)	N						
	B09	短鎖型塩化パラフィン	N						
	C01	アスベスト類	N						
	C02	アゾ染料・顔料	N						
C04	オゾン層破壊物質	N							
C06	放射性物質	N							
レベルB (管理)	A01	アンチモン及びその化合物	Y	14,000	0.025	SPDT-SW2のモールド	エポキシ系樹脂		
			Y	10,000	0.016	CMOS2のモールド樹脂	難燃助剤		
			Y	10,000	0.016	CMOS6のモールド樹脂	難燃助剤		
			N	100,000	0.015	シグナルプロセッサ2のエポキシ樹脂	難燃剤		
			N	290	0.019	モジュール本体銘板基材	触媒残渣		
			N	2,000	0.0041	LNAオーバコート樹脂	エポキシ系樹脂		
			N	1,100	0.0016	PA1	はんだ合金中の不純物		
			Y	10,000	0.091	PA1封止樹脂	信頼性の向上		
			N	1,100	0.0016	PA2	はんだ合金中の不純物		
			Y	10,000	0.092	PA2封止樹脂	信頼性の向上		
			Y	35,000	0.0070	水没判定ラベル1両面テープ基材	添加剤		
			Y	11,000	0.33	ダイオード(19個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
			Y	10,000	0.11	トランジスタ(9個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
			N	250	0.00037	モジュールバーコート部	触媒残渣		
			N	1,000	0.28	モジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
			Y	10,000	0.050	パススイッチのモールド樹脂	難燃助剤		
			Y	20,000	5.0	インタフェイスICの封止樹脂	難燃剤		
			Y	20,000	11.0	VTG-REGのモールド封止材料	難燃助剤		
			Y	14,000	0.046	CMOS5のレジソ	難燃剤		
			Y	18,000	0.028	リセットICのモールド樹脂	難燃剤		
			Y	41,000	0.12	スライドSW1のスライダ	樹脂難燃剤		
			Y	69,000	2.0	DIPスライドSWのスライダ	樹脂難燃剤		
			Y	32,000	24	PB用コネクタ6のハウジング	難燃剤		
			Y	32,000	37	PB用コネクタ5のハウジング	難燃剤		
			Y	62,000	130	PB用コネクタ4のインシュレータ	樹脂添加剤		
			Y	62,000	0.26	RFケーブルの絶縁座	難燃助剤		
			Y	8,600	0.21	CMOS4のモールド	難燃剤		
			Y	35,000	3.5	アンテナコネクタワッシャー基材	添加剤		
			N	290	0.0084	モジュールラベル基材	触媒残渣		
			N	2,700	0.24	フレキケーブル接着剤	添加剤		
Y	35,000	0.014	水没判定ラベル2両面テープ基材	添加剤					
N	250	0.00045	アダプタバーコート部	触媒残渣					
N	1,000	0.093	アダプタ部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物					

【Reference Data】FOMA UM01-KO アダプタセット

有害物質含有情報調査結果

NTTDOCOMO Highly Confidential
 @2008 NTT DOCOMO,INC. All Rights Reserved
 FOMAユビキタスマジュール

本資料はJGSPSSI(グリーン調達調査共通化協議会)の定めるJGSPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 フォーマット2(詳細型)に基づき記載しております。
 詳細はJGSPSSI 製品含有化学物質調査・回答マニュアル第4.1版 をご参照いただきますようお願いいたします。
 ただし、下記部品については、フォーマット1(標準型)に基づき、大きさ、用途、形状毎に分類し含有濃度:最大値、含有質量:総含有量を記載し、横に個数を併記しております。
 ①コンデンサ、抵抗 → 大きさ(縦×横)
 ②ダイオード、トランジスタ → 用途
 ③コイル → 形状

- ・本資料に記載された内容は予告無く変更させていただき場合がございます。
- ・本資料は「UMテクニカルサポート利用規約 情報の取り扱い」に定められた文書となります。
- ・利用条件を遵守していただけますよう、よろしくお願いたします。

※JIG-101A閾値レベルによる

分類	No.	物質名	※含有判定	含有濃度 (ppm)	含有質量 (mg)	含有用途含有部位	含有の理由	適用除外への対応状況	備考
A02		ひ素及びその化合物	Y	100,000	0.0090	SPDT-SW2のICチップ	GaAs素子		
			N	300	0.0020	LSIの基板	銅箔中の不純物		
			N	18	0.010	モジュール基板のコア材(銅箔)	不純物		
			N	5.0	0.000025	WCDMA RF-IC	ドーパント		
			N	9.3	0.0000074	VC-TCXOのIC	IC成分		
			Y	100,000	0.094	LNA素子	GaAs素子		
			Y	520,000	0.16	PA1の半導体チップ	特性を得るため		
			N	88	0.00013	PA1	はんだ合金中の不純物		
			Y	520,000	0.16	PA2の半導体チップ	特性を得るため		
			N	88	0.00013	PA2	はんだ合金中の不純物		
			N	300	0.084	モジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
			N	5.0	0.0000012	CMOS5チップ	ドーパント		
			N	5.0	0.0000038	CMOS4チップ	ドーパント		
			N	250	0.0020	LEDの端子処理	基板端子処理材		
			A03		バリウム及び化合物	N	2,000	0.000014	ターナル本体
N	20,000	0.016				スライドSW1コネクタ	合金成分		
N	19,000	1.7				コネクタ2の雄雌中継端子	銅合金の成分		
A04		ビスマス及びその化合物	Y	10,000	0.25	LSIモールド材	モールド材添加物		
			N	40,000	0.012	WCDMA RF-ICの外部端子	めっき材料		
			N	440	0.00066	PA1	はんだ合金中の不純物		
			Y	10,000	0.091	PA1封止樹脂	信頼性の向上		
			N	440	0.00066	PA2	はんだ合金中の不純物		
			Y	10,000	0.092	PA2封止樹脂	信頼性の向上		
			N	500	0.14	モジュール部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物		
			判定不可	1,600	0.0036	COMS5のフレーム	めっき		
判定不可	非開示	非開示	チョークコイルのセラミック	特性確保					
N	500	0.047	アダプタ部品実装用クリームはんだ	はんだ合金中の不純物					
A11		ニッケル(外部利用のみ)	N						
A13		セレン又はその化合物	N						
B07		ポリ塩化ビニル(PVC)	N						
B08		臭素系難燃剤	Y	21,000	0.033	CMOS6のモールド樹脂	難燃剤		
			N	100,000	0.056	シグナルプロセッサ2のエポキシ樹脂	難燃剤		
			Y	37,000	0.12	ダイオード(19個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
			Y	35,000	0.043	トランジスタ(9個)の外装樹脂	樹脂難燃剤		
			Y	20,000	0.099	ハススイッチのモールド樹脂	難燃剤		
			Y	28,000	0.095	CMOS5のレジジ	難燃剤		
			Y	110,000	83	PB用コネクタ6のハウジング	難燃剤		
			Y	110,000	130	PB用コネクタ5のハウジング	難燃剤		
			Y	150,000	320	PB用コネクタ4のインシュレータ	難燃剤		
			Y	310,000	1.3	RFケーブルの絶縁座	難燃剤		
			Y	21,000	0.51	CMOS4のモールド	難燃剤		
			Y	69,000	2000	アダプタ基板	難燃剤		
			Y	310,000	27	フレキケーブル接着剤	難燃剤		
C05		フタル酸エステル類	N						

注意事項

- ※ 本調査結果には、メーカー非開示の為、一部含有判定不可能なデータが含まれます。
- ※ 本調査結果は、メーカーの購入先からの報告により記載しているものであり、含有・非含有または含有数量を保証するものではありません。